

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-55

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	申万宏源证券、中泰证券、西部利得基金、国泰基金
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年9月6日
地点	公司会议室；机构投资者所在地（上海）
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务产品下游应用分布变化情况。</b></p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。报告期内，公司 PCB 业务在数据中心及汽车电子领域占比较去年同期有所提升。</p> <p><b>Q2、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务在通信领域经营拓展情况。</b></p> <p>公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2024 年上半年，通信市场不同领域需求分化较大，无线侧通信基站相关产品需求未出现明显改善，有线侧 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求在 AI 相关需求的带动下有所增长，助益公司通信领域 PCB 产品结构优化，盈利能力有所改善。</p>

**Q3、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务在数据中心领域经营拓展情况。**

数据中心是公司 PCB 业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024 年上半年，全球主要云服务厂商资本开支规模明显回升，并重点用于算力投资，带动 AI 服务器相关需求增长，叠加通用服务器 EGS 平台迭代升级，服务器总体需求回温。公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于 AI 加速卡、EGS 平台产品持续放量等产品需求提升。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。

**Q4、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务在汽车电子领域经营拓展情况。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一，主要面向海外及国内 Tier1 客户，以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向。2024 年上半年，公司 PCB 业务在汽车电子领域继续重点把握上述方向的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求释放，智能驾驶相关高端产品需求稳步增长，推动汽车电子领域业务占比提升。

**Q5、请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。**

与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。例如 ADAS 领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高，涉及高频材料、HDI 工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现，汽车也可能演变为新型的移动数据终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

**Q6、请介绍公司 2024 年上半年封装基板业务在下游市场拓展情况。**

2024 年上半年，公司封装基板业务 BT 类产品紧抓市场局部需求修复机会，并加快新产品和新客户导入，推动订单较去年同期明显增长，需求整体延续去年第四季度态势；FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

**Q7、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。**

公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。

**Q8、请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。**

公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。

**Q9、请介绍公司近期 PCB 及封装基板工厂稼动率较二季度变化情况。**

公司近期 PCB 工厂稼动率较 2024 年第二季度基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。

**Q10、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。**

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。

**Q11、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。**

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2024 年上半年，铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动，贵金属等部分辅材价格出现一定涨幅，部分板材价格在二季度末有所上浮，整体保持平稳，未对公司 2024 年上半年度经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

**Q12、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。**

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。

关于本次活动是否涉及

调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

应披露重大信息的说明	
附件清单	无